

- ab 08:00 Uhr **Registrierung und Networking**
- 09:00 – 09:10 Uhr **Begrüßung Doris Jetter**, Chefredakteurin EPP, Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH
- 09:15 – 10:00 Uhr **LED meets SMT 2.0 – Advanced Process**  
**Kurt-Jürgen Lang**, Senior Key Expert Processing, OSRAM Opto Semiconductors GmbH
- 10:00 – 10:30 Uhr **LED meets SMT – Der Beitrag der Leiterplatte**  
**Ferdinand Lutschounig**, Produktmanager Thermal Conductive PCB, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
- 10:30 – 11:00 Uhr **Kaffeepause**
- 11:00 – 11:30 Uhr **Legierungen wie Innot und HT1 gewinnen bei Hochtemperaturen bis 170°C an Bedeutung**  
**Jörg Trodler**, Technical Solution Manager Assembly Materials, Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG
- 11:30 – 12:00 Uhr **Schablonenlayout für komplexe LED-Bauformen**  
**Dipl.-Ing.(FH) Harald Grumm**, Projektleiter Schablonendrucker, Ersa GmbH
- 12:00 – 12:30 Uhr **Präzisionsbestückung – „LEDs genau beschreiben“**  
**Dipl.-Ing. Norbert Heilmann**, Senior Product Manager und Technologie Scout, ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
- 12:30 – 13:30 Uhr **Mittagspause**
- 13:30 – 14:00 Uhr **Der Lebenszyklus der LED beginnt gravierend beim Lötprozess**  
**Axel Wolff**, Head of Sales, ASSCON Systemtechnik-Elektronik GmbH
- 14:00 – 14:30 Uhr **Prüfstrategien mit 3D-AXI für eine optimale Prozesskontrolle**  
**Andreas Gladis**, Vertrieb Europa, Viscom AG
- 14:30 – 15:00 Uhr **Norm konformes Reflowlöten – Was ist möglich? Aktuelle Entwicklungen**  
**Dr. Hans Bell**, Forschung & Entwicklung, Rehm Thermal Systems GmbH
- 15:00 – 15:30 Uhr **Kaffeepause**
- 15:30 – 16:00 Uhr **Lumineszenz und Transparenz**  
**Wolfgang Runte**, Sales Manager, Koh Young Europe GmbH
- 16:00 – 16:30 Uhr **Qualitätsbeurteilung von LED-Modulen in rauen Umgebungsbedingungen**  
**Dr. Markus Meier**, Technologie Entwicklung, ZESTRON Europe ... a Business Division of Dr. O.K. Wack Chemie GmbH
- bis ca. 17:00 Uhr **Abschlussdiskussion und Verabschiedung**